

|                 |                         |                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Produkt</b>  | <b>OT2-SCANGe071-T4</b> |                 |
| <b>Datum</b>    | 2018.05.18              |                 |
| <b>Freigabe</b> | 15.2                    | <b>Lotpaste</b> |
| <b>Sprache</b>  | Deutsch                 |                 |

## ZUSAMMENFASSUNG

Bleifreie, silberreduzierte, halogen- und halogenidfreie Lotpaste gegen Grabsteine bei Fine-Pitch-Anwendungen

| LOTPASTE         | OT2-SCANGe071-T4 |   |
|------------------|------------------|---|
| PROZESS          |                  |   |
| No-Clean Prozess |                  | 5 |
| Nachreinigung    |                  | 5 |

| INDUSTRIEANWENDUNGEN              |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Konsumerelektronik                |  | 4 |
| Standardelektronik                |  | 5 |
| High Tech Elektronik (Automotive) |  | 4 |

| PROZESSTAUGLICHKEIT                  |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Rakel                                |  | 5 |
| ProFlow                              |  | 4 |
| Bleifreies Profil Luft, kurz         |  | 5 |
| Bleifreies Profil Luft, lang         |  | 5 |
| N2 Prozess bleifrei                  |  | 5 |
| Dampfphase                           |  | 5 |
| Glänzende Lötstellen                 |  | 3 |
| Optisch saubere Leiterplatten        |  | 5 |
| Kompatibel mit Incirciut-Test (ICCT) |  | 5 |
| Kompatibel mit Überzugslacken        |  | 4 |

| Inhalt  |  |   |
|---|--|---|
| Speziell für diese Anwendung entwickelt       |  | 5 |
| Generell für diese Anwendung qualifiziert     |  | 4 |
| Generell anwendbar, aber nicht die beste Wahl |  | 3 |
| Generell nicht für diese Anwendung nutzbar    |  | 2 |
| Falsche Auswahl                               |  | 1 |

| KLASSIFIZIERUNG              |            |
|------------------------------|------------|
| DIN-EN-29454-1: 1994         | 1.1.3.C    |
| IPC-J-STD-004-A: 2004        | ROLO       |
| IPC-J-STD-005: 1995 (Pulver) | T4         |
| Partikelgröße                | [µm] 20-38 |

| EIGENSCHAFTEN              |                    |               |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| Flussmittel                | OT2                |               |
| Legierungstyp              | SCANGe071          |               |
| Legierungszusammensetzung  | Sn98.3Cu0.7Ag1NiGe |               |
| Liquidus                   | [°C]               | 225           |
| Solidus                    | [°C]               | 217           |
| Empfohlene Spitztemperatur | [°C]               | 232-260       |
| Säurezahl                  | [mg KOH/g]         | 139.5         |
| Flussmittelgehalt          | [% w/w]            | 12.2          |
| Farbe der Rückstände       | Colorless          |               |
| Klebekraft Malcom TK1      | JIS-Z-3284         | [gf] @ 0h 120 |

| TESTBERICHT(E)             |                     |                 |           |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| IPC/ANSI-J-STD-005         |                     |                 | Compliant |
| COC - Qualitätszertifikate |                     |                 | Website   |
| RoHS-Konformitätserklärung |                     |                 | Available |
| Anwendungshinweise         |                     |                 | EN/DE     |
| Kupferspiegel              | IPC-TM-650 2.3.32   |                 | L         |
| Halogenide                 | IPC-TM-650 2.3.33   | [Silberchromat] | Pass      |
| Halogenide                 | IPC-TM-650 2.3.35.1 | [Fluoride]      | Pass      |
| Kupferkorrosion            | IPC-TM-650 2.6.15   |                 | L         |
| SIR                        | IPC-TM-650 2.6.3.3  |                 | Pass      |
| ECM                        | IPC-TM-650 2.6.14.1 |                 | Pass      |

| VERPACKUNG UND LAGERUNG      |          |      |
|------------------------------|----------|------|
| Dose                         | PP [g]   | 500  |
| Kleine Kartusche             | HDPE [g] | 650  |
| Große Kartusche              | HDPE [g] | 1300 |
| Kassette                     | [g]      | 800  |
| Mindesthaltbarkeit (Monaten) | 4-10 °C  | 12   |

Überprüfen Sie die Verträglichkeit nach jedem Prozesswechsel.

Chemisches Industrieprodukt

Wir verweisen auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt.

### Disclaimer: (D)

Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden.